

# Allgemeine Hinweise

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2003

Informieren Sie auch Ihnen bekannte Absolventen über die Veranstaltung.

Teilnahmegebühren:

- Mitglieder: EUR 20,00
- Nichtmitglieder: EUR 30,00
- Studenten (Nichtmitgl.): EUR 5,00
- Studenten (Mitglieder): frei
- Abendveranstaltung: EUR 20,00

Wir bitten um Überweisung an:

Verein akad. Holz-Ing.  
Konto-Nr.: 346 034 472  
BLZ: 850 551 42  
Stadtsparkasse Dresden  
Stichwort: 11. Holz-Kolloquium

## ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEIT

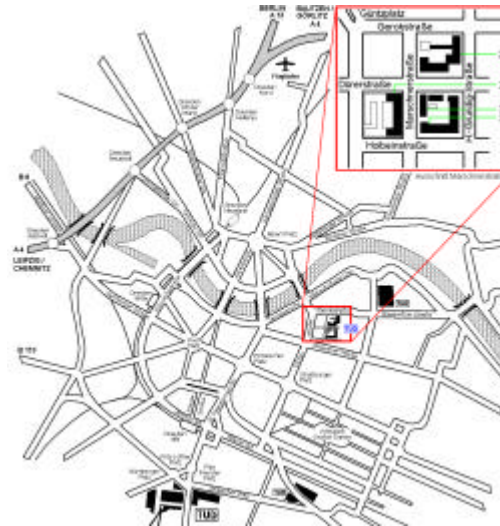
Gästehaus „Am Weberplatz“  
Weberplatz 7, 01217 Dresden  
Tel. 0351-4 67 93 00  
Fax 0351-4 67 93 94

Anmeldung bitte bis zum 30.09.2003 unter „11. Holztechnologisches Kolloquium“

# Organisatorisches

**Tagungsort:**

Gebäude der Landesversicherungsanstalt  
Holbeinstraße 1; Raum 6005



**Informationen:**

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN  
Lehrstuhl für Holz- und Faserwerkstofftechnik  
<http://www.tu-dresden.de/mw/ihp/hft/hft.html>

Frau Dr. U. Kröppelin      Tel. 0351-46 33 81 07  
Frau R. Erdmann          Tel. 0351-46 33 81 01  
   Fax 0351-46 33 82 88  
E-mail:                        vah@mhp.mw.tu-dresden.de

# 11. Holztechnologisches Kolloquium Dresden

“Leichtbau mit Holz”



**07. November 2003**

Mitgliederversammlung  
des  
Vereins  
akademischer  
Holzingenieure



Verein akademischer  
Holzingenieure e.V.

## Zum Anliegen

Eine bedeutsame Innovationsquelle bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte und Dienstleistungen ist der Leichtbau.

Der Leichtbau ist eine interdisziplinäre Ingenieurwissenschaft, die ein werkstoff- und produktübergreifendes Wissen erfordert. Auch in der Holzindustrie gewinnen Leichtbaulösungen durch produktions- und kundenspezifische Anforderungen zunehmend an Bedeutung.

Zum diesjährigen 11. Holztechnologischen Kolloquium hat sich deshalb der Lehrstuhl Holz- und Faserwerkstofftechnik der TU Dresden mit Unterstützung durch den Verein akademischer Holzingenieure an der TU Dresden e.V. und der "Dresdner Interessengemeinschaft Holz" der Thematik "Leichtbau mit Holz" gewidmet.

Mit aktuellen Vortragsangeboten möchten wir ein Forum mit fachkompetenten Referenten des In- und Auslandes gestalten und damit einen regen Erfahrungsaustausch unter Fachkollegen schaffen.

Wir dürfen Sie ganz herzlich zu dieser Fachveranstaltung und die Mitglieder des Absolventenvereins zur anschließenden Mitgliederversammlung einladen!

Ihr

Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ

## Programm

Freitag, 07. November 2003

Moderation: Dr.-Ing. K. Rehm

- 10:00 Uhr **Begrüßung**  
Dekan der Fakultät Maschinenwesen  
Technische Universität Dresden
- 10:15 Uhr **Leichtbau in der Holzindustrie**  
Prof. Dr.-Ing. A. Wagenführ;  
Dr.-Ing. U. Kröppelin  
Technische Universität Dresden  
Dipl.-Ing. T. Pursche  
INNOTECH Holztechnologien  
GmbH Berlin
- 10:45 Uhr **Kostengünstige Sandwich-Bauteile mit Papierwabenkern**  
Dipl.-Ing. J. Pflug  
Katholische Universität Leuven,  
Belgien
- 11:15 Uhr **Formleichtbau mit 3D Lagenholzschalen**  
Dr.-Ing. A. Möller  
REHOLZ GmbH, Kesselsdorf
- 11:45 Uhr **Pause**
- 12:00 Uhr **Maßgeschneiderte Holzwerkstoffe für Leichtbau- und Verbundbauweise**  
Univ.-Prof. A. Teischinger,  
Universität für Bodenkultur Wien  
Institut für Holzforschung

## Programm

- 12:30 Uhr **Holzfaserverplatten als Leichtbauwerkstoff**  
Dr.-Ing. M. Müller  
Glunz AG, Meppen
- 13:00 Uhr **Pause**
- 13:15 Uhr **Neue Klebstoff-entwicklungen für die Herstellung von Sandwich-Konstruktionen**  
Ing. (grad.) D. Kunkel  
Fa. Jowat, Detmold
- 13:45 Uhr **Entwicklung und Vermarktung eines innovativen Türensystems aus formverleimten Schalentragwerken**  
Dipl.-Ing. (FH) H. Krischer  
Krischer Gesellschaft für innovative Fenstersysteme, Oberzissen
- 14:15 Uhr **Ende des 11. Holz-technologischen Kolloquiums**
- 15:00 Uhr **Mitgliederversammlung**
- ab 18:30 Uhr **Abendveranstaltung**  
Feldschlößchen-Stammhaus  
Budapester Str. 32  
01069 Dresden



Bitte senden Sie Ihre Rückantwort per Fax, Post oder E-Mail bis zum **15. Oktober 2003** an uns zurück.

## RÜCKANTWORT

FAX: (0351) 46 33 82 88  
e-mail: [erdmann@mhp.mw.tu-dresden.de](mailto:erdmann@mhp.mw.tu-dresden.de)

Technische Universität Dresden  
Institut für Holz- und Papiertechnik  
Lehrstuhl für Holz- und Faserwerkstofftechnik

D-01062 Dresden

**Holztechnologisches Kolloquium am 07. November 2003**

Teilnahme Kolloquium	Ja	Nein
-------------------------	----	------

Teilnahme Mitgliederversammlung VAH	Ja	Nein
--	----	------

Teilnahme <b>nur</b> Abendveranstaltung	Ja	Nein
--	----	------

Interesse an zusätzlicher Präsentation	Ja	Nein
---	----	------

? Zutreffendes bitte ankreuzen

ABSENDER:

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon:

DATUM

Unterschrift